

# 基于 MDK 开发的 TencentOS-Tiny Software Pack TencentOS-Tiny software package based on MDK development

2021/9/3

东南大学

导师: 汪礼超

学员: 崔林威

 $\underline{https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny}$ 

# 目录

1,	ARM 软件包介绍	3
	1.1 软件包简介	3
	1.2 软件包开发	3
	1.2.1 软件包开发过程	3
	1.2.2 PDSC 文件的编写	3
	1.2.3 生成软件包	7
2,	TencentOS-tiny 软件包	9
	2.1 软件包内容	9
	2.2 软件包安装	9
3、	软件包测试	11
	3.1 ARM 内核移植 TencentOS tiny 软件包	11
	3.2 STM32 不依赖裸机工程移植	13
	3.3 单片机裸机工程移植	16
4、	总结	20
5、	开发参考	20
6、	附录-移植配置参考	20
	6.1 MDK5.14 版本移植到 ARM 内核	20
	6.1.1 Cortex-M0 内核移植	20
	6.1.2 Cortex-M0+内核移植	21
	6.1.3 Cortex-M3 内核移植	21
	6.1.4 Cortex-M4 内核移植	21
	6.1.5 Cortex-M7 内核移植	22
	6.2 MDK5.14 版本移植到基于 ARM 内核的芯片	23
	6.2.1 移植到 stm32f103c8 芯片	
	6.2.2 移植到 stm32f767igt 芯片	23
	6.3 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植(Cortex-M0+、0、3、4、7 内核和芯片)	24
	6.3 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植(Cortex-M23、33)	
	6.3.1 Cortex-M23 内核移植	24
	6.3.2 Cortex-M33 内核移植	25

## 1、ARM 软件包介绍

#### 1.1 软件包简介

在进行嵌入式软件开发时,ARM 为我们提供了软件包功能,能够将软件算法等模块进行集成封装,从而方便第三方用户使用。ARM 软件包能够为微控制器设备和开发板提供支持,包含软件组件(Software Component)如驱动程序和中间件,还可以包含示例项目和代码模板等,主要有以下类型的软件包:

- (1) 器件系列包(Device Family Pack): 由硅供应商或工具供应商生成,为特定的目标微控制器创建软件应用提供支持:
- (2) 板级支持包(Board Support Pack): 由电路板供应商发布,为安装在电路板上的外围硬件提供软件支持。
  - (3) CMSIS 软件包:由 ARM 提供,包括对 CMSIS 核心、DSP 和 RTOS 的支持;
- (4) 中间件包(Middleware Pack): 由芯片供应商、工具供应商或第三方创建; 通过提供对常用软件组件(如软件堆栈、特殊硬件库等)的软件集成, 从而减少开发时间;
  - (5) 内部组件(In-house components): 由工具用户开发,用于内部或外部分发。软件组件包括以下几部分:
  - (1) 源代码、库、头文件/配置文件和文档;
  - (2) 完整的示例项目,展示了软件组件的使用,可以下载并在评估硬件上执行;
  - (3) 代码模板,方便使用软件组件。
- 一个完整的软件包是一个 ZIP 文件,包含所有需要的软件库和文件,以及一个包含软件包 所 有 信 息 的 包 描 述 文 件 ( PDSC 文 件 ), 软 件 包 的 结 构 是 在 CMSIS 中 定 义 的 (http://www.keil.com/CMSIS/Pack)。

#### 1.2 软件包开发

#### 1.2.1 软件包开发过程

软件包的开发过程相当于完成了一项产品的制作,因此引入产品生命周期管理(PLM)的概念,PLM包括以下四个阶段: (1)概念的产生,基于软件包需求进行产品定义,并创建第一个功能原型; (2)设计,根据技术特征和要求,进行原型测试和产品的实施,通过广泛的测试验证产品的功能与规格; (3)发布,产品被制造出来并推向市场; (4)服务,对产品的维护,包括对客户的支持,最后不断优化,结束产品的周期。

在制作软件包时,主要面临以下几个过程:

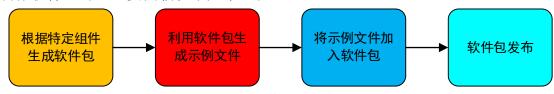


图 1.1 软件包开发流程

首先,根据特定组件生成软件包即根据需求将相应的头文件、库文件等软件组件利用 PDSC 文件进行组织,在组织完成后即可利用软件包生成工具生成对应版本的软件包,然后对新生成的软件包进行测试,给出示例测试程序,再将其包含如 PDSC 文件中,最后经测试完成后生成最终的软件包。

#### 1.2.2 PDSC 文件的编写

PDSC 文件时基于可扩展标记语言(XML)进行编写的,能够将软件包包含的各个模块按

照特定的格式组织起来,接下来按照 PDSC 文件的结构对文件的编写进行详细介绍:

首先是 PDSC 文件的开头,前两句是声明为 XML 格式,它是在 MDK 中的 PACK.xsd 文件定义的,所以不用修改; <name>和<vendor>标签定义了软件包的基本内容,也用于 PACK 文件的文件名,故该 PDSC 文件应命名为 Tencent.TencentOS-tiny.pdsc; <description>标签描述了软件包的信息,它将显示在包安装程序中; <url>标签可以包含一个带有软件包下载链接的网址,方便用户下载; license>标签包含了用户使用该软件包时需要遵守的协议, <supportContact>标签表示软件包的支持人员联系方式,可以提供一个电子邮件地址或网页 URL。如图 1.2 为下列代码对应的软件包界面。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<package schemaVersion="1.0" xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xs:noNamespaceSchemaLocation="PACK.xsd">
<name>Tencent</name>
<description>Description of your pack</description>
<vendor>TencentOS-tiny</vendor>
<url>https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny</url>
license>LICENSE.txt</license>
<supportContact>...</supportContact>
```

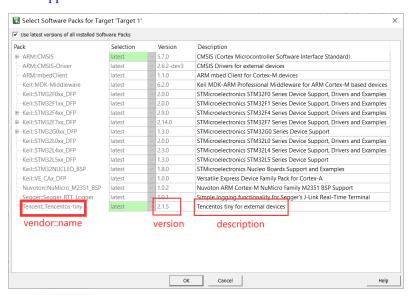


图 1.2 程序对应的软件包

接下来是 PDSC 文件的各个模块, <releases>标签定义了软件包的版本, 开发者可以在版本 更新时在此进行标注, 从而在生成软件包时, 系统会自动生成最新版本的软件包;

```
<releases>
<release version="1.0.1">
Sep/3/2021, version name
</release>
<release version="1.0.0">
Sep/1/2021, version name
</release>
</release>
```

<taxonomy>标签用于定义每个组件的 description,如图 1.3 所示,通过下列代码中的 Cclass、Cgroup 和 Csub 来确定 description 所在的位置,doc 用于指定 description 文件(也可以不加),然后添加 description 的名字。

#### <taxonomy>

<description Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="xx" Csub="xx" doc="examples/index.html">TencentOS
tiny</description>

×

</taxonomy>

Manage Run-Time Environment

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
■ ◆ Board Support		MCBSTM32E ~	2.0.0	Keil Development Board MCBSTM32E
•				Cortex Microcontroller Software Interface Components
CMSIS Driver				Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specifications
Device				Startup, System Setup
■ ❖ File System		MDK-Pro	6.2.0	File Access on various storage devices
Graphics		MDK-Pro	5.26.1	User Interface on graphical LCD displays
• • Network		MDK-Pro	6.2.0	IP Networking using Ethernet or Serial protocols
Segger Tools				
→ TencentOS tiny		MDK-ARM	1.0.0	TencentOS tiny
⊕ ◆ arch				<taxonomy> description</taxonomy>
⊕ ❖ cmsis_os				,
⊕ ♦ kernel				

图 1.3 <taxonomy>标签

<keywords>标签定义了软件包的关键词,在ARM 官网下载软件包时可利用关键词搜索到需要的软件包。

#### <keywords >

<keyword>Tencent</keyword>

#### </keywords >

< requirements >标签定义了软件包的关联安装需求,即在安装本软件包时,还需要在网上安装其他包(网址: MDK5 Software Packs (keil.com)),例如下面的定义则需要我们安装 ARM的 CMSIS5.7.0 软件包。

接下来是<conditions>标签,该标签在设计<components>时使用,用以说明软件包中各个组件的依赖关系,即使用本组件还需要选择其他组件。在该标签下可以定义多个 condition,每个 condition 可以定义多个条件,其中<conditions id>表示条件名,<description>为条件信息,然后便是定义的条件,其中<accept>表示该条件时可选的,当同时存在多个<accept>时,用户需要至少满足其中一个条件才可以使用;<require>表示该条件是必选的,否则便无法使用相应的组件。在条件内部,包含一些特定的指示性语法,如果在设计<component>的时候开发者选择了名为Cortex\_M0 的条件,那么用户在使用该<component>时,则需要遵守条件要求:其中<accept Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>表示用户需要选择 ARM-Cortex M0 内核,<require condition="condition id "/>为条件嵌套,表示用户还需要满足该条件对应的要求,<require Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="kernel" Csub="core"/>表示用户还需要选择 core 组件。

```
<require Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="kernel" Csub="core"/>
</condition>
```

#### </conditions>

然后是<components>标签,该标签描述了软件包包含的所有文件,在编写该标签下的程序时,需要按照文件类别将文件进行划分,在下列代码中,定义了一个 Keil:: TencentOS tiny:: arch::arch 的<component>,<description>为该组件的信息,具体如图 1.4 所示。

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
⊕ ◆ CMSIS				Cortex Microcontroller Software Interface Components
CMSIS Driver				Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specifications
Device				Startup, System Setup <taxonomy>description</taxonomy>
		MDK-Pro	6.2.0	File Access on various storage devices
		MDK-Pro	5.26.1	User Interface on graphical LCD displays
Network		MDK-Pro	6.2.0	IP Networking using Ethernet or Serial protocols
⊕ ❖ Segger Tools		Cvariant		
◆ Tencentos tiny Cclass				
arch Cgroup			Cversion	<component>description</component>
□ arch Csub	<b>~</b>		1.0.1	arch for arm_v7m_cortex_m4_armcc
⊕ ❖ cmsis_os				
example				
⊕ ♦ kernel				
⊕ ❖ USB		MDK-Pro	6.2.0	USB Communication with various device classes
⊕ ◆ mbed				

图 1.4 < component>定义界面

#### <components>

</component>

condition="condition id"即为上述介绍的<condition>标签,从而用户在使用该组件时,还需要满足 condition 所要求的依赖组件。另外,在定义某一个<component>时,需要按照上面程序的<files>...</files>语法进行文件添加,其中 file category 的定义如表 1-1 所示,在 name 中可以添加文件路径和具体的某个文件,在软件包中,我们添加的文件默认是不可编辑的,为了方便用户对文件进行进行配置,我们需要添加 attr="config"属性,并可通过 version 更新不同版本的文件。

category	含义
doc	文件,可以是网页或者其他链接
include	包含某一个路径下的所有头文件
header	包含某路径下的具体头文件
source	.c 源文件

表 1-1 file category 定义

为了使我们设计的软件包能够适配不同的内核,即在使用软件包时与用户 ARM 核不一致的文件都不出现,可以按如下步骤进行<files>的添加:(1)在 condition 条件中,加入<require

Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>这样的程序,该程序表示需要用户选择 ARM Cortex-M0 内核;(2)在添加<files>时,我们可以将针对不同内核,同一类型文件的 Cgroup 和 Csub保持同样的名字,并添加上(1)中定义的 condition,这样用户选择不同内核时,将只会出现与该内核一致的文件。

```
<components>
    <bundle Cbundle="MDK-ARM" Cclass="TencentOS tiny" Cversion="1.0.0">
        <description>TencentOS tiny</description>
        <doc>examples/index.html</doc>
        <component
            <!-- 组件内容 -->
        </component>
    </bundle>
    <bundle Cbundle="MDK-ARM" Cclass="TencentOS tiny" Cversion="1.0.0">
        <description>TencentOS tiny</description>
        <doc>examples/index.html</doc>
        <component
            <!-- 组件内容 -->
        </component>
    </bundle>
</component>
```

另外,PDSC 文件还可以包含<devices>、<apis>、<boards>和<examples>,这些为 ARM 公司或者其他器件、开发板厂商提供,为针对器件、api 库文件、板级和相应的示例文件,具体可以参阅 ARM CMSIS 的软件包。

最后,PDSC 文件后还需要在最后加上</package>,表示该文件的结束,从而完成 PDSC 文件的编写。

#### 1.2.3 生成软件包

在完成 PDSC 文件的编写后,为了生成最终的软件包,还需要准备如图 1.5 所示的 3 个文件,其中 PackChk.exe 用于验证软件包包含的文件是否都存在,即是否完整; gen\_pack.bat 为 Windows 批处理文件,需要我们对文件中的路径进行修改,并用于生成软件包; PACK.xsd 是 schema,主要用来制定 XML 规范,用以验证我们编写的 PDSC 文件。另外,还需要准备 7-Zip File Manager 软件,用于对文件进行压缩,制作集成的软件包。

PackChk.exe	2021/7/19 22:39	应用程序	2,485 KB
	2021/9/2 14:16 2021/7/19 22:39	Windows 批处理文件 XML Schema File	3 KB 85 KB
	₽Z		

7-Zip File Manager

图 1.5 生成软件包所需的软件配置

首先利用记事本或 Notepad++打开 gen\_pack.bat,对以下几个地方需要修改,如表 1-2 所示:
SET ZIPPATH=C:\Program Files\7-Zip
SET RELEASE PATH=..\Local Release

SET PACK VENDOR=Tencent

SET PACK NAME=TencentOS-tiny

SET PACK FOLDER LIST=arch osal kernel examples

SET PACK\_FILE\_LIST=%PACK\_VENDOR%.%PACK\_NAME%.pdsc README.md LICENSE.txt

表 1-2 gen pack.bat 修改内容

代码	含义
SET ZIPPATH	7-Zip File Manager 软件的安装路径
SET RELEASE_PATH	生成的软件包路径,为相对路径
SET PACK_VENDOR	PDSC 文件中的 <vendor>标签</vendor>
SET PACK_NAME	PDSC 文件中的 <name>标签</name>
SET PACK_FOLDER_LIST	软件包包含文件所在路径
SET PACK_FILE_LIST	README.md LICENSE.txt 所在路径

修改完毕 gen\_pack.bat 后,便可以制作软件包了,首先利用 cmd 打开电脑的命令行界面,执行 cd 命令转到 gen\_pack.bat 所在的路径,然后输入 gen\_pack.bat 点击 enter,如图 1.6 所示,gen\_pack.bat 会按照顺序压缩文件,然后读取 PDSC 文件,检查数据完整性和文件依赖是否完整,然后生成软件包,当提示 gen pack.bat completed successfully 后就完成了软件报的创建。

图 1.6 软件包生成界面

此时在 Local Release 路径下,可以看到生成的软件包。



# 2、TencentOS-tiny 软件包

腾讯物联网操作系统(TencentOS tiny)是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统,具有低功耗,低资源占用,模块化,可裁剪等特性。TencentOS tiny 提供了最精简的 RTOS 内核,内核组件可裁剪可配置,可灵活移植到多种终端 MCU 上。而且,基于 RTOS 内核,提供了COAP/MQTT/TLS/DTLS 等常用物联网协议栈及组件,方便用户快速接入腾讯云物联网通信 IoT Hub。同时,TencentOS tiny 为物联网终端厂家提供一站式软件解决方案,方便各种物联网设备快速接入腾讯云,可支撑智慧城市、智能水表、智能家居、智能穿戴、车联网等多种行业应用。

因此,为了有效减少开发人员在移植 TencentOS tiny 到 ARM 内核单片机上的开发时间,本文基于 MDK 完成了第三方 TencentOS Tiny pack 和软件包的封装,能够使用 MDK pack 直接 生成适合不同 MCU 的 TencentOS Tiny 工程。

#### 2.1 软件包内容

结合 TencentOS tiny 的算法架构,本文设计的软件包包括如表 2-1 所示的内容: 表 2-1 软件包内容

	7C 2 1 1/7	II CHA		
内	容	功能		
arch		包括 TencentOS-tiny\arch\arm 下内核为 Cortex-		
		M0+, Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4,		
		Cortex-M7、Cortex-M23、Cortex-M33 的 arch 文件		
kernel		包括 TencentOS-tiny\kernel 下的 core、hal 路径中的		
		文件、tos_config 文件		
cmsi	s_os	对应 TencentOS-tiny\osal\cmsis_os 的文件		
avamala.	helloworld_main	用于测试软件包的 main 文件		
example	mcu_it.c	移植软件包时需要按照该文件对中断函数进行修改		
	mcu_platform.h	用户可在此文件在添加对应单片机的头文件		

#### 软件包具有以下功能:

- (1)软件包针对 ARMCortex-M0+、Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M23 和 Cortex-M33 内核进行了 TencentOS tiny 软件的封装,用户在安装软件包后能够快速将 TencentOS tiny 相应内核的 Keil 工程中;
- (2) 软件包能够自动适应用户所选的内核, arch 文件能够根据内核自动显示, 从而方便用户使用;
- (3)用户在勾选一个组件时,软件包会自动提示还需要勾选其他模块,并可利用界面中的 Resolve 一键勾选,防止遗漏;
- (4) 用户可自主修改对应内核的 tos\_config 文件,对 TencentOS tiny 的功能进行裁剪。 2.2 软件包安装

接下来介绍 Tencent.TencentOS-tiny 软件包的安装,首先双击图 1.5 中的软件包,然后进入安装界面,如图 2.1(a),点击 I agree to all the terms of the preceding License Agreement,再点击 next 进行安装,安装完成界面如图 2.1(b)所示;

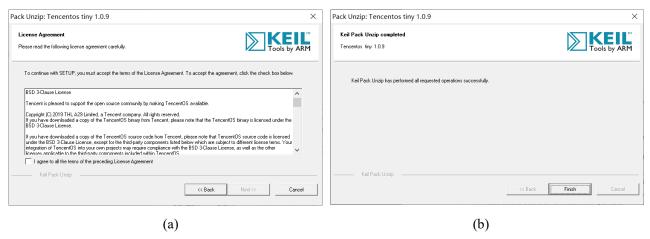


图 2.1 安装界面

此时软件包已经安装到 Keil 5 之中,打开 Keil 5 软件,并点击 Pack Installer 图标,可以进行不同软件包版本的安装与移除:

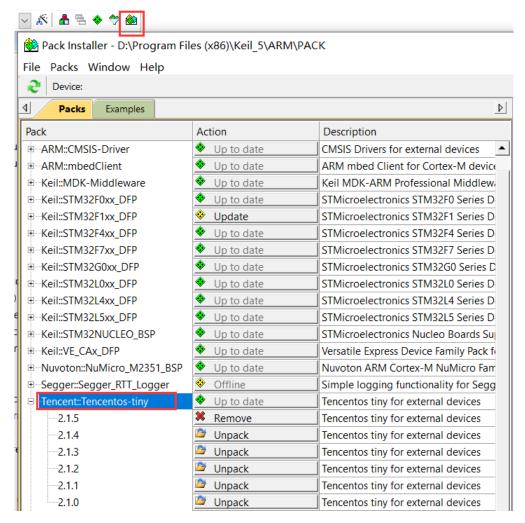


图 2.2 Pack Installer 界面

接下来就可以安装 Tencent.TencentOS-tiny 软件包中的组件,点击 Manage Run-Time Environment 图标,对需要从软件包中移植的文件进行勾选,如图 2.3 所示,如果有依赖可以点击 Resolve 进行一键安装。

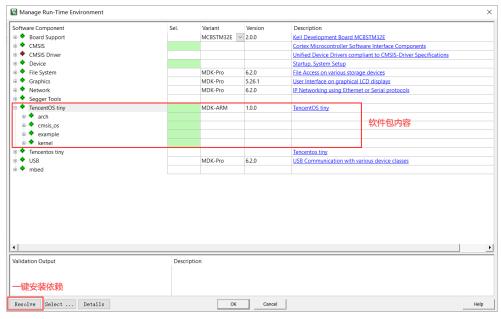


图 2.3 Manage Run-Time Environment 界面

# 3、软件包测试

#### 3.1 ARM 内核移植 TencentOS tiny 软件包

首先在 MDK5 Software Packs (keil.com)下载安装 ARM CMSIS-5.8.0 软件包,以便在不同内核下测试本软件包。



图 3.1 ARM CMSIS-5.8.0 软件包

在安装完软件包后,以ARM Cortex-M3 内核为例对软件包进行移植,并进行编译,首先利用 Keil5-5.30 版本软件新建工程,并选择 ARMCM3,如图 3.2 所示,然后按照图 3.3 勾选相应的 TencentOS-tiny 组件和 Cortex-M3 内核文件,可以看到 arch 和 tos\_config 都已经根据内核进行了自动适配。

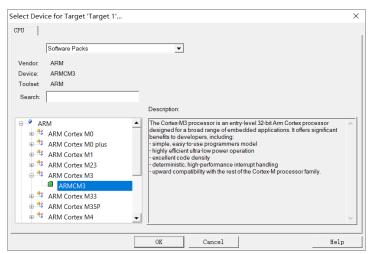


图 3.2 勾选内核

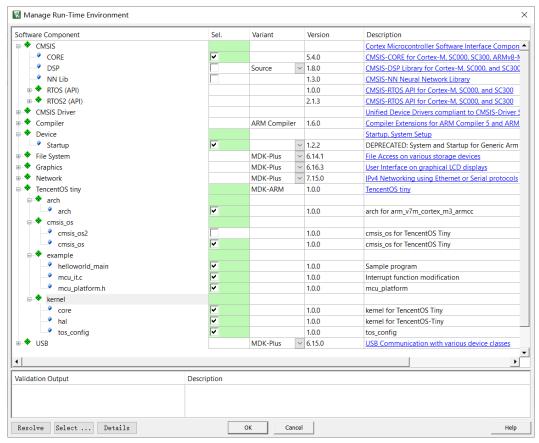


图 3.3 勾选组件

接下来点击 Options for target, 选中 Use MicroLIB 和默认编译版本 5, 然后选择 C99 mode。

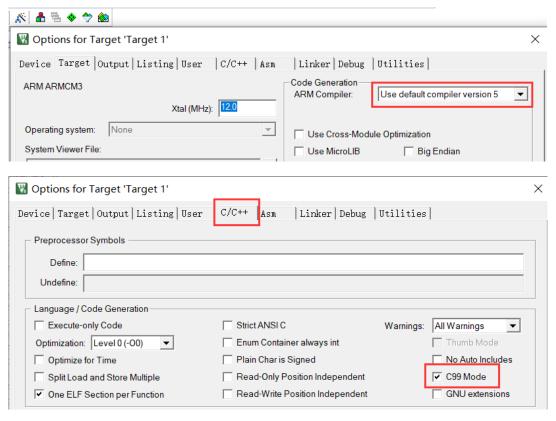


图 3.4 选中 Use MicroLIB

然后在 mcu platform.h 中添加#include "ARMCM3.h"和#include "core cm3.h"头文件。

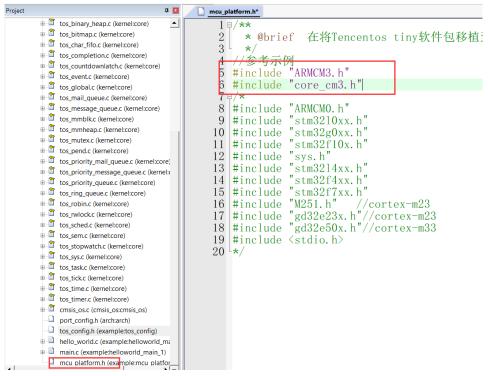


图 3.5 添加对应内核的头文件

最后点击 Build 图标进行测试,如图 3.6 所示:

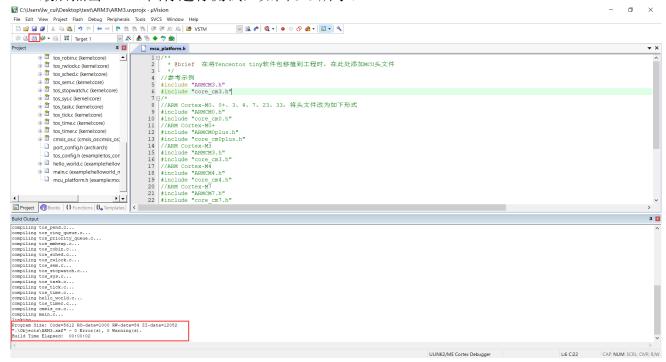


图 3.6 编译测试

与之类似,如果要在 ARM Cortex-M4 内核下对本软件包进行测试,只需要在上述步骤修改 mcu\_platform.h 中的头文件为#include "ARMCM4.h"和#include "core\_cm4.h"即可,如果是其他内核则对应修改头文件。

#### 3.2 STM32 不依赖裸机工程移植

接下来选取具体单片机芯片,进行软件包的测试,按照以下步骤:

在网站 MDK5 Software Packs (keil.com)上下载 STM32F1 的软件支持包,如图 3.7 所示,并

#### 进行安装。

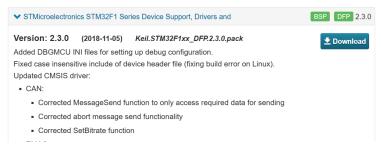


图 3.7 STM32 软件支持包

新建工程,选择芯片为 STM32F103C8,如图 3.8 所示,然后点击 ok,按照图 3.9 所示,选择 TencentOS-tiny 软件包的组件和 STM32 的启动文件。

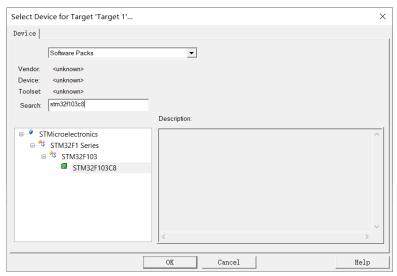


图 3.8 选择 STM32F103C8 芯片

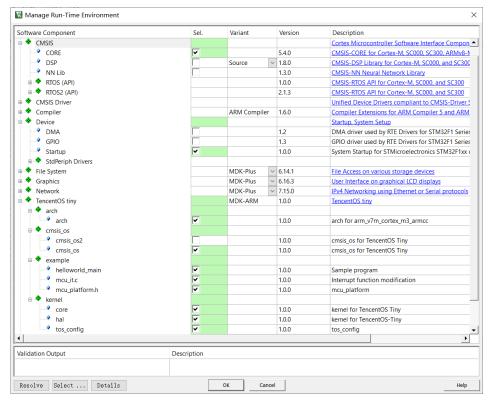


图 3.9 选择组件

然后按照图 3.10(a)所示勾选 Use MicroLIB 和编译版本 5, 并选择 C99mode。

Options for Target 'Target 1'					>
evice Target Output Listing Use	r   C/C++   Asm	Linker Debug	Utilities	s	
ARM ARMCM3 Xtal (M	Hz): 12.0	Code Generation ARM Compiler:	Use defaul	lt compiler version 5	▼
Operating system: None	▼	Use Cross-Modul	e Optimizati	on	
System Viewer File:		Use MicroLIB	_ B	Big Endian	
	(a	)			
Options for Target 'Target 1'					×
,					
evice   Target   Output   Listing   Use: - Preprocessor Symbols	C/C++ Asm	Linker Debug	Utilities		
evice   Target   Output   Listing   Use:  — Preprocessor Symbols  — Define:  Undefine:	C/C++ Asm	Linker Debug	Utilities		
Preprocessor Symbols  Define: Undefine:  Language / Code Generation	C/C++ Asm				<b>-</b>
evice   Target   Output   Listing   Use:  — Preprocessor Symbols  — Define:  Undefine:	Strict ANSI C		Utilities  Warnings:		
evice   Target   Output   Listing   Use:  — Preprocessor Symbols  — Define:  — Undefine:  — Language / Code Generation  — Execute-only Code	Strict ANSI C	iner always int		All Warnings	
Preprocessor Symbols  Define: Undefine:  Language / Code Generation  Execute-only Code Optimization: Level 0 (-00)	Strict ANSI C Enum Conta	iner always int		All Warnings Thumb Mode	

图 3.10 软件设置

然后按照图 3.11, 在 mcu platform.h 中添加以下头文件:

#include "stm32f10x.h"

#include "core\_cm3.h"

#include "system stm32f10x.h"



图 3.11 修改 mcu\_platform.h

最后点击 Build 编译,没有报错则移植成功。

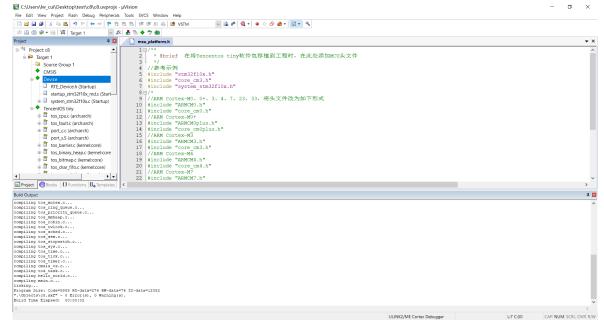


图 3.12 编译界面

#### 3.3 单片机裸机工程移植

最后对单片机开发板进行测试,以正点原子探索者 STM32F407ZGT6 为例介绍 TencentOStiny 软件包的移植。如下图为软件包勾选的内容:

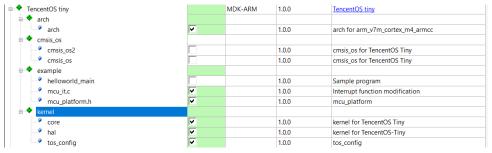


图 3.13 软件包组件勾选

在正点原子探索者 STM32F407ZGT6 裸机工程模板中移植软件包后的界面如图 3.14 所示:

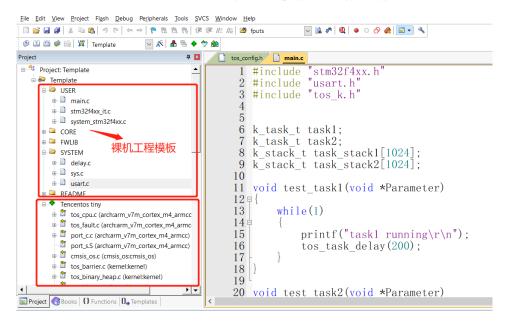


图 3.14 移植界面

然后按照 mcu\_it.c 对 stm32f4xx\_it.c 中的 PendSV\_Handler()函数和 SysTick\_Handler()函数进行修改,如下图所示,注释 stm32f4xx\_it.c 中的 PendSV\_Handler()函数,并修改SysTick Handler()函数。

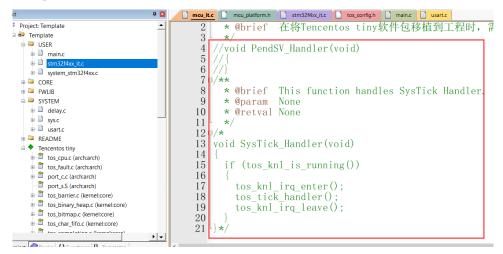


图 3.15 函数修改

## 接下来,使用如下 main 程序:

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart.h"
#include "tos k.h"
k task t task1;
k task t task2;
k stack t task stack1[1024];
k stack t task stack2[1024];
void test task1(void *Parameter)
     while(1)
          printf("task1 running\r\n");
          tos_task_delay(200);
void test task2(void *Parameter)
     k err t err;
     printf("task2 running\r\n");
     tos_task_delay(2000);
     // suspend task1 暂停
     printf("suspend task1\r\n");
     err = tos task suspend(&task1);
     if(err != K ERR NONE)
          printf("suspend task1 fail! code : %d \r\n",err);
     tos task delay(2000);
     // resume task1 恢复
     printf("resume task1\r\n");
     err = tos task resume(&task1);
```

```
if(err != K ERR NONE)
         printf("resume task1 fail! code : %d \r\n",err);
    tos task delay(2000);
    // destroy task1 销毁
    printf("destroy task1\r\n");
    err = tos task destroy(&task1);
    if(err != K ERR NONE)
         printf("destroy task1 fail! code : %d \r\n",err);
    // task2 running
    while(1)
         printf("task2 running\r\n");
         tos task delay(1000);
  *@brief 主函数
  *@param 无
  * @retval 无
int main(void)
    k err t err;
    /*初始化 USART 配置模式为 115200 8-N-1, 中断接收*/
    uart init(115200);
    printf("Welcome to TencentOS tiny\r\n");
    tos knl init(); // TOS Tiny kernel initialize
    tos_robin_default_timeslice_config((k_timeslice_t)500u);
    printf("create task1\r\n");
    err = tos task create(&task1, "task1", test task1, NULL, 3, task stack1, 1024, 20);
    if(err != K ERR_NONE)
         printf("TencentOS Create task1 fail! code : %d \r\n",err);
    printf("create task2\r\n");
    err = tos task create(&task2, "task2", test task2, NULL, 4, task stack2, 1024, 20);
    if(err != K ERR NONE)
         printf("TencentOS Create task2 fail! code : %d \r\n",err);
    tos knl start(); // Start TOS Tiny
```

然后点击编译,并利用 ST LINK-V2 将程序下载到单片机上,如图 3.16,然后将单片机的 串口与电脑连接起来,利用 XCOM 串口通讯助手进行查看,结果如图 3.17 所示。

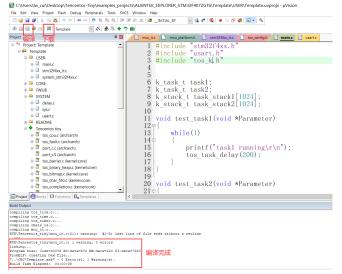


图 3.16 编译界面



图 3.17 测试界面

另外,在编译过程中如果遇到图 3.18(a)的报错,需要将图 3.18(b)中的#define TOS CFG OBJECT VERIFY EN 1u 修改为 TOS CFG OBJECT VERIFY EN 0u

```
Build Output

compiling tos_priority_queue.c...
compiling tos_ring_queue.c...
compiling tos_robin.c...
compiling tos_robin.c...
compiling tos_sched.c...
compiling tos_sem.c...

Di\Program Files (x86)\Keil_5\ARM\PACK\Tencentos\tiny\2.0.8\kernel\core\tos_sem.c(66): error: $136: struct "k_sem_st" has no field "knl_obj"
knl_object_alloc_set_dynamic(&the_sem->knl_obj);

D:\Program Files (x86)\Keil_5\ARM\PACK\Tencentos\tiny\2.0.8\kernel\core\tos_sem.c(91): error: $136: struct "k_sem_st" has no field "knl_obj"
if (knl_object_alloc_is_dynamic(&sem->knl_obj)) {

D:\Program Files (x86)\Keil_5\ARM\PACK\Tencentos\tiny\2.0.8\kernel\core\tos_sem.c(91): error: $136: struct "k_sem_st" has no field "knl_obj"
if (knl_object_alloc_is_dynamic(&sem->knl_obj)) {

D:\Program Files (x86)\Keil_5\ARM\PACK\Tencentos\tiny\2.0.8\kernel\core\tos_sem.c: 0 warnings, 2 errors
compiling tos_stopwatch.c...
compiling tos_sys.c...
```

图 3.18 报错修改

#### 4、总结

本文首先研究了基于 MDK 完成第三方软件包封装的开发过程,并编写了软件包制作的步骤,然后结合 TencentOS Tiny 物联网操作系统,对其中的 ARM 内核架构下的文件进行了封装,从而设计了基于 TencentOS Tiny 的软件包。

本软件包能够方便开发者快速地将 TencentOS Tiny 操作系统移植到用户的 ARM 内核单片机上,大大节省了开发移植的时间,同时软件包具有自动适配内核和依赖提示的功能,能够提高移植的效率。

# 5、开发参考

- 1、腾讯物联网操作系统网址 https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny
- 2、MDK5 软件包 MDK5 Software Packs (keil.com)
- 3、制作软件包培训视频 <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1AK411p7d9">https://www.bilibili.com/video/BV1AK411p7d9</a>
- 4、制作软件包博客 https://blog.csdn.net/qq 40259429/article/details/119320319
- 5、制作简易软件包 https://www.cnblogs.com/libra13179/p/6273415.html
- 6、CMSIS-Driver 软件包 <u>ARM-software/CMSIS-Driver</u>: <u>Repository of microcontroller peripheral</u> driver implementing the CMSIS-Driver API specification (github.com)
- 6、附录-移植配置参考
- 6.1 MDK5.14 版本移植到 ARM 内核
- 6.1.1 Cortex-M0 内核移植
  - (1) Manage Run-Time Environment 勾选如下:

Manage Run-Time Environment					>
Software Component	Sel.	Variant		Version	Description
⊕ ◆ CMSIS					Cortex Microcontroller Software Interface Compone
CORE	V			5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M
DSP DSP		Source	~	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
→ NN Lib				1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
⊕ ◆ RTOS (API)				1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
⊕ ◆ RTOS2 (API)				2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
					Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver S
⊕ ◆ Compiler		ARM Comp	iler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM
□ ◆ Device					Startup, System Setup
Startup	<b>~</b>		~	1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm
■ ◆ File System		MDK-Plus	~	6.14.1	File Access on various storage devices
		MDK-Plus	~	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
■ ◆ Network		MDK-Plus	~	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
■ ◆ TencentOS tiny		MDK-ARM		1.0.0	TencentOS tiny
⊕ ◆ arch					
arch	<b>▽</b>			1.0.0	arch for arm_v6m_cortex_m0_armcc
⊕ ◆ cmsis_os					
cmsis_os2				1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	<b>▽</b>			1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
helloworld_main	<b>▽</b>			1.0.0	Sample program
mcu_it.c	V			1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<b>▽</b>			1.0.0	mcu_platform
B ◆ kernel					
core	<b>▽</b>			1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<b>▽</b>			1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	V			1.0.0	tos_config

(2) 在 mcu platform.h 中添加:

#include "ARMCM0.h" #include "core cm0.h"

- 6.1.2 Cortex-M0+内核移植
- (1) Manage Run-Time Environment 勾选如下:

Software Component	Sel.	Variant		Version	Description
◆ CMSIS					Cortex Microcontroller Software Interface Componer
→ CORE	<b>▼</b>			5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M,
→ DSP		Source	~	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib				1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
⊕ ◆ RTOS (API)				1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
				2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver					Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Sp
◆ Compiler		ARM Compi	ler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM C
					Startup, System Setup
Startup	V		~	1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm (
File System		MDK-Plus	~	6.14.1	File Access on various storage devices
◆ Graphics		MDK-Plus	~	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
		MDK-Plus	~	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
◆ TencentOS tiny		MDK-ARM		1.0.0	TencentOS tiny
⊕ ◆ arch					
arch	<u>~</u>			1.0.0	arch for arm_v7m_cortex_m0+_armcc
⊕ ❖ cmsis_os					
cmsis_os2				1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	V			1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
⊕ ❖ example					
helloworld_main	V			1.0.0	Sample program
mcu_it.c	V			1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	V			1.0.0	mcu_platform
B-◆ kernel					
core	V			1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	V			1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
o tos config	V			1.0.0	tos config

(2) 在 mcu platform.h 中添加:

#include "ARMCM0plus.h"

#include "core cm0plus.h"

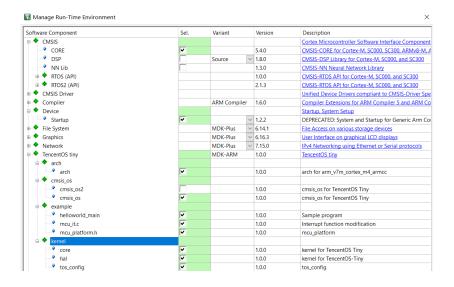
- 6.1.3 Cortex-M3 内核移植
  - (1) Manage Run-Time Environment 勾选如下:

Software Component	Sel.	Variant		Version	Description
₽ ◆ CMSIS					Cortex Microcontroller Software Interface Componen
CORE	<b>▽</b>			5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M,
DSP DSP		Source	~	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib				1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
				1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
				2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
◆ CMSIS Driver					Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Sp
Compiler		ARM Compi	ler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM C
Device					Startup, System Setup
Startup	<b>▼</b>		~	1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm C
File System		MDK-Plus	~	6.14.1	File Access on various storage devices
◆ Graphics		MDK-Plus	~	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
• Network		MDK-Plus	~	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
<ul> <li>TencentOS tiny</li> </ul>		MDK-ARM		1.0.0	TencentOS tiny
arch arch	<b>▼</b>			1.0.0	arch for arm_v7m_cortex_m3_armcc
⊕ ❖ cmsis_os					
cmsis_os2				1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	<b>▽</b>			1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
⊕ ◆ example					
helloworld_main	<b>▽</b>			1.0.0	Sample program
mcu_it.c	<b>▼</b>			1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<b>▼</b>			1.0.0	mcu_platform
core	<b>▼</b>			1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<b>▼</b>			1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	<b>▽</b>			1.0.0	tos_config

(2) 在 mcu\_platform.h 中添加:

#include "ARMCM3.h" #include "core cm3.h"

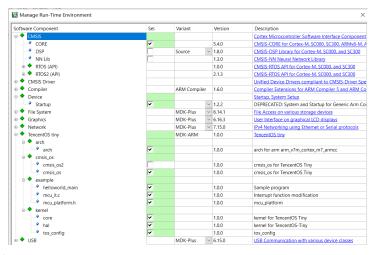
- 6.1.4 Cortex-M4 内核移植
- (1) Manage Run-Time Environment 勾选如下:



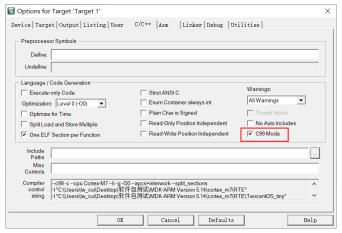
(2) 在 mcu\_platform.h 中添加:

#include "ARMCM4.h" #include "core cm4.h"

- 6.1.5 Cortex-M7 内核移植
- 1、Manage Run-Time Environment 勾选如下:



2、在 MDK 中修改为 C99



3、在 mcu platform.h 中添加:

#include "ARMCM7.h" #include "core cm7.h"

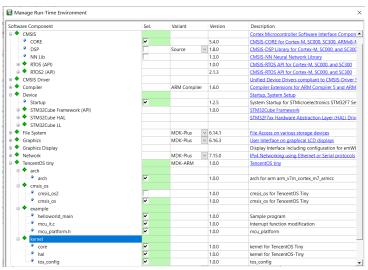
- 6.2 MDK5.14 版本移植到基于 ARM 内核的芯片
- 6.2.1 移植到 stm32f103c8 芯片
- 1、Manage Run-Time Environment 勾选如下:

oftware Component	Sel.	Variant		Version	Description
Board Support		MCBSTM32C	~	2.0.0	Keil Development Board MCBSTM32C
→ CMSIS					Cortex Microcontroller Software Interface Compon
→ CORE	<b>▽</b>			5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-1
→ DSP		Source	~	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
→ NN Lib				1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
				1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
⊕ ◆ RTOS2 (API)				2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
<ul> <li>CMSIS Driver</li> </ul>					Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver
◆ Compiler		ARM Compile	er	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM
Device					Startup, System Setup
→ DMA				1.2	DMA driver used by RTE Drivers for STM32F1 Serie
→ GPIO				1.3	GPIO driver used by RTE Drivers for STM32F1 Serie
→ Startup	<b>▼</b>			1.0.0	System Startup for STMicroelectronics STM32F1xx
◆ File System		MDK-Plus	~	6.14.1	File Access on various storage devices
◆ Graphics		MDK-Plus	~	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
Network		MDK-Plus	~	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
<ul> <li>TencentOS tiny</li> </ul>		MDK-ARM		1.0.0	TencentOS tiny
⊕ ◆ arch					
→ arch	<b>▽</b>			1.0.0	arch for arm_v7m_cortex_m3_armcc
⊕ ◆ cmsis_os					
cmsis_os2				1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	V			1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
⊕ ◆ example					
helloworld_main	<b>V</b>			1.0.0	Sample program
mcu_it.c	<b>V</b>			1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<b>V</b>			1.0.0	mcu_platform
⊕ ◆ kernel					
core	<b>V</b>			1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
→ hal	<b>▼</b>			1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
<ul> <li>tos_config</li> </ul>	<b>▽</b>			1.0.0	tos config

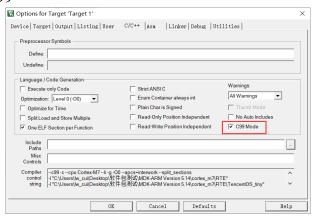
2、在 mcu platform.h 中添加:

#include "stm32f10x.h"
#include "core\_cm3.h"
#include "system stm32f10x.h"

- 6.2.2 移植到 stm32f767igt 芯片
- 1、Manage Run-Time Environment 勾选如下:



2、在 MDK 中修改为 C99

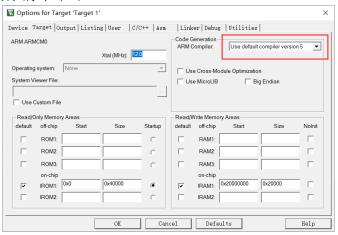


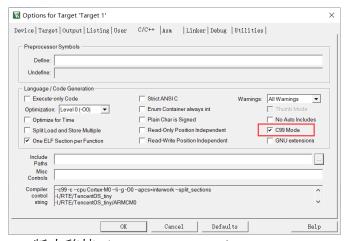
## 3、在 mcu platform.h 中添加:

#include "stm32f7xx.h"
#include "core\_cm7.h"
#include "system stm32f7xx.h"

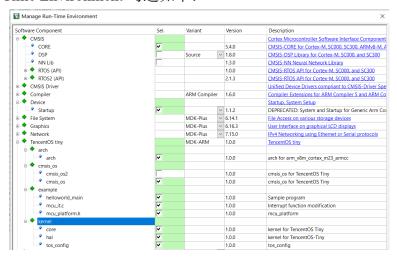
6.3 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植(Cortex-M0+、0、3、4、7 内核和芯片)

在 MDK5.30 和 MDK5.35 版本的 Keil 移植 TencentOS-tiny Pack 时,对于 Cortex-M0+、0、3、4、7 的内核和芯片,勾选组件和添加头文件的步骤之前一致,但是需要修改编译器的版本,具体修改如下,然后执行编译即可。





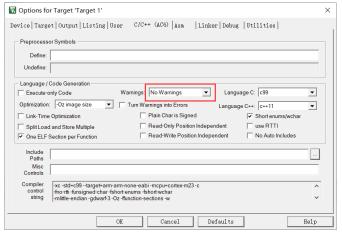
- 6.3 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植(Cortex-M23、33)
- 6.3.1 Cortex-M23 内核移植
  - (1) Manage Run-Time Environment 勾选如下:



(2) 在 mcu platform.h 中添加:

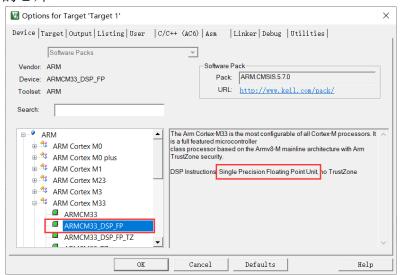
#include "ARMCM23.h" #include "core cm23.h"

(3) 修改为不查看报错:

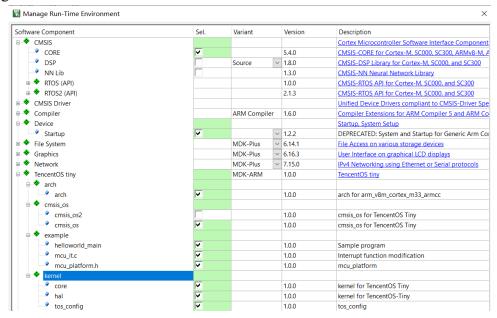


#### 6.3.2 Cortex-M33 内核移植

(1) 选择带 FPU 的芯片



(2) Manage Run-Time Environment 勾选如下:



(3) 在 mcu\_platform.h 中添加:

#include "ARMCM33\_DSP\_FP.h" #include "core cm33.h"

(4) 修改为不查看报错:

